

アルファデザインの実装機 全自動シリーズ

APF-200 プレスフィットコネクタ圧入装置

- 特徴**
- ・ハンダレスにより環境にやさしい装置。
 - ・工程の簡素化により製品のコストダウンが可能。

① 全自動によりインライン化を実現

- ・ツールの自動交換

② 正確な加圧管理

- ・指定された角度、指定荷重、指定位置、荷重平均の4種モード監視

③ 安全性

- ・加圧プロファイルの管理により、基板やコネクタにダメージを与えない

④ 最速を実現

- ・軽量加圧ヘッド機構により、治具搬送速度が1,000mm/sec(X-Y)実現



AFC-200 超高性能フリップチップボンダー

- 特徴**
- ・コンパクト設計により、開発・試作・量産対応に最適。
 - ・正確なファインピッチ接合を実現。

① 画像認識精度 $3\sigma = \pm 1\mu\text{m}$

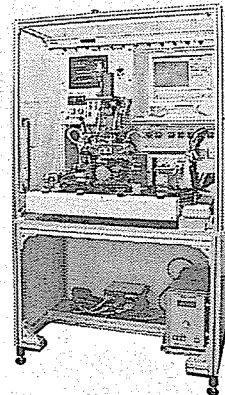
- ・オリジナル画像処理システムにより、微細ICチップ搭載を実現

② 低加重ヘッド Min. 0.5N

- ・ツール交換によるマルチ接合工法に対応
- ・パルスヒート/コンスタントヒート
- ・超音波接合

③ 多様な接合試料に対応

- ・COG、COF、LED、光デバイス、シリコンインターポザー等

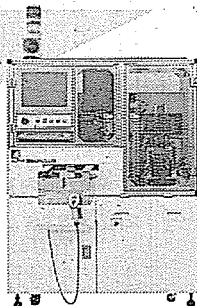


ACTシリーズ 搭載・移載

- 特徴**
- 画像アライメント機能による製品の位置補正機能を有し従来のピッカーやテーピングでは実現出来ないうークの高精度な移載を実現しました。トレーとのクリアランスが少ない製品やWL-CSP、ガラス、MEMS等、側面に触れたくないデリケートな製品に適したピックアップ機及びテーピング機です。新機種として、装置内にディスペンサーを装備しての搭載機(マウンター)も各種品揃えております。

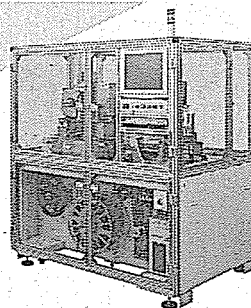
ACT-120 リング to トレイ

ダイシング済みのテーピング上のチップ部品をテープから剥離して、トレイに収納するピックアップ機



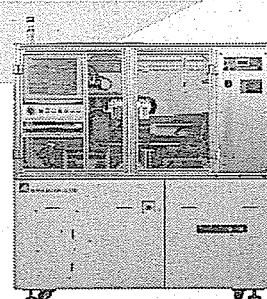
ACT-210 トレイ to テープ

トレイ内のチップ部品を、エンボステープに収納するテーピング機



ACT-600 チップ搭載

基板などにディスペンサーして、ワークを搭載するチップ搭載機



**ALPHA
DESIGN**

アルファデザイン株式会社 HP <http://www.alpha-design.co.jp/> E-mail info@alpha-design.co.jp

本社・工場 〒389-0511 長野県東御市滋野甲 2211-3
東京支社 〒389-0511 東京都荒川区東日暮里 5-51-11 静屋ビル7F
大阪支社 〒570-0074 大阪府守口市文園町5-12

Tel 0268-64-0088 Fax 0268-64-0080
Tel 03-5850-4788 Fax 03-5850-4789
Tel 06-6998-0588 Fax 06-6998-7988